

第42期 中間報告書

2019年4月1日から2019年9月30日まで

京都発 → 世界へ

株主の皆さまへ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、当社第42期中間報告書（2019年4月1日から2019年9月30日まで）をお届けし、事業の概況等についてご報告申し上げます。

当第2四半期連結累計期間における世界経済は、長引く米中貿易戦争による中国経済の減速が世界経済に波及したことにより、景気悪化の懸念が高まっております。また、底堅いと見られていた米国経済では、製造業の景況感が一段と後退し、雇用者数の伸びにも鈍化が見られる等、減速懸念が高まりました。日本経済につきましても輸出や生産の弱さが続いており、先行きは依然として不透明な状況です。

半導体業界におきましては、米中貿易戦争の先行き不透明感から顧客の設備投資意欲に未だ力強さは感じられないものの、次世代通信規格「5G」の基地局向け需要が好調なことや、メモリー価格に底入れ感が見られること等から、一部では設備投資への前向きな動きが見られ、低迷していた半導体市況にやや回復の兆しが見え始めました。

このような状況のもと、当社グループは半導体モルディング装置のリーディングカンパニーとして、今後の本格展開が予想されるWLP（ウェハーレベルパッケージ）やPLP（パネルレベルパッケージ）の量産化に向けたソリューションを提供してまいりました。また、当社のコア技術である超精密加工技術を応用展開した受託加工の売上高が、当第2四半期連結累計期間で前年通期（2018年4月～2019年3月期）を超える大幅な伸びを見せる等、安定した収益体質の実現に向けた事業展開を進めてまいりました。

当第2四半期連結累計期間における経営成績は、売上高116億41百万円（前年同期比36億56百万円、23.9%減）、営業損失1億81百万円（前年同期は営業利益8億73百万円）、経常損失2億83百万円（前年同期は経常利益9億54百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失2億1百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益8億81百万円）となりました。なお、中間配当は見送りとさせていただきますが、期末配当につきましては1株当たり16円を予定しております。

引き続き株主の皆さまのご期待にお応えいたすべく、今後も「ものづくり企業の真価に挑む」を合言葉に、企業価値の増大を図ってまいりますので、何卒一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2019年12月



代表取締役社長

岡田博和

連結財務諸表

● 四半期連結貸借対照表 (要旨)

(単位: 百万円)

科 目	当第2四半期末 2019年9月30日現在	前期末 2019年3月31日現在
【 資 産 の 部 】		
流 動 資 産	24,712	26,835
現金および預金	8,208	7,651
受取手形および売掛金	8,036	9,352
電子記録債権	104	188
たな卸資産	7,750	8,282
その他	614	1,362
固 定 資 産	18,299	17,133
有形固定資産	13,176	12,117
建物および構築物	3,706	3,921
土地	4,343	4,366
その他の	5,127	3,830
無形固定資産	548	657
投資その他の資産	4,575	4,358
資産合計	43,011	43,968
【負債および純資産の部】		
流 動 負 債	11,719	11,485
支払手形および買掛金	1,470	1,631
電子記録債権	729	953
短期借入金	5,900	5,500
一年以上返済予定長期借入金	1,105	910
その他	2,515	2,491
固 定 負 債	4,463	4,759
長期借入金	3,479	4,086
その他	984	673
負債合計	16,182	16,245
株 主 資 本	25,640	26,099
資本剰余金	8,932	8,932
利益剰余金	462	462
自己株	16,257	16,715
株	△ 11	△ 11
その他の包括利益累計額	1,097	1,516
非支配株主持分	91	106
純資産合計	26,829	27,722
負債・純資産合計	43,011	43,968

(注) 当第1四半期連結会計期間より一部の在外子会社について、IFRS16号を適用しております。

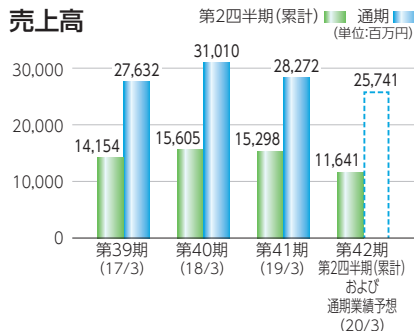
● 四半期連結損益計算書 (要旨)

(単位: 百万円)

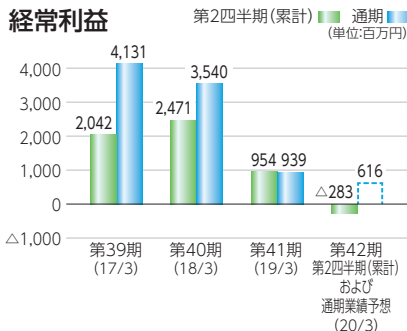
科 目	当第2四半期(累計) 2019年4月1日から 2019年9月30日まで	前第2四半期(累計) 2018年4月1日から 2018年9月30日まで
売 上 高	11,641	15,298
売 上 原 価	8,959	11,474
売 上 総 利 益	2,682	3,823
販売費および一般管理費	2,864	2,950
営 業 利 益	△ 181	873
営 業 外 収 益	98	116
営 業 外 費 用	199	35
経 常 利 益	△ 283	954
特 別 利 益	0	13
特 別 損 失	0	7
税金等調整前四半期純利益	△ 283	959
法 人 税 等	△ 74	77
四 半 期 純 利 益	△ 208	881
非支配株主に帰属する四半期純利益	△ 7	—
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 201	881

連結財務ハイライト

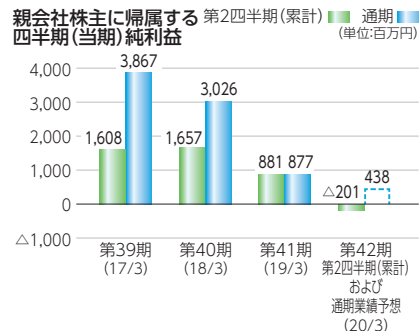
売上高



経常利益



親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益



新子会社TOWA THAI (タイ) が発足

7月、当社の販売子会社であるTOWA THAI COMPANY LIMITEDが政府の認可を受け、本格的に事業をスタートさせました。タイは日系企業の進出が盛んな国であり、当社も約20年前からタイで販売活動を行ってまいりましたが、このたび現地法人を作ることで更に地域に根ざした販売活動を展開してまいります。従来の半導体関連製品の販売・サービスの提供に加え、精密加工用工具の販売等、新事業分野の販路拡大も目指してまいります。

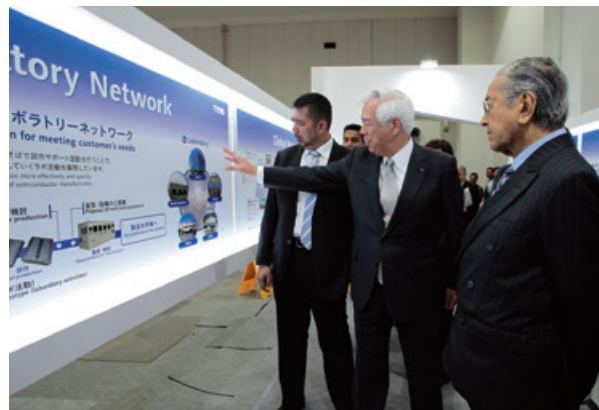


マレーシア マハティール首相来社

9月、マレーシアのマハティール・ビン・モハムド首相が当社本社に来訪されました。

社長の岡田が工場を案内し、当社独自技術を採用したコンプレッション装置やコア技術を応用展開したナノテック、コーティングなどの新事業について説明を行いました。

首相は、質問も交えながら興味深く工場をご覧になり、また、当社のマレーシア新工場にも関心を示され、生産予定の製品に関するご質問もいただきました。



会社の概要 (2019年9月30日現在)

商号	TOWA株式会社 (英文名 TOWA CORPORATION)
設立	1979年4月17日
資本金	8,932,627,777円
本社所在地	京都市南区上烏羽上調子町5番地 ☎ (075) 692-0250 (代表)
従業員数	539名(単体) 1,557名(連結)
ホームページ	http://www.towajapan.co.jp
上場取引所	東京証券取引所市場第一部

役員	代表取締役社長	岡田博和
	取締役常務執行役員	浦上浩
	取締役常務執行役員	田村吉住
	取締役上席執行役員	石田耕一
	取締役常勤監査等委員	小林久芳
	社外取締役監査等委員	桑木肇
	社外取締役監査等委員	和氣大輔
	上席執行役員	早坂昇
	執行役員	蒲生喜代重
	執行役員	鈕方舜
	執行役員	韓相倫
	執行役員	柴原信隆

株式の状況 (2019年9月30日現在)

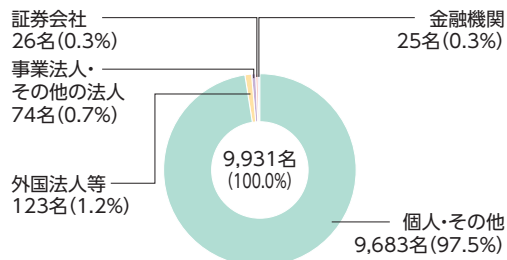
- 発行可能株式総数 80,000,000株
- 発行済株式の総数 25,021,832株
- 株主数 9,931名
- 大株主

株主名	持株数	持株比率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	3,298 千株	13.19 %
BBH(LUX) FOR FIDELITY FUNDS PACIFIC FUND	2,015	8.06
株式会社 ケイビー恒産	2,000	8.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社	1,116	4.47
資産管理サービス信託銀行株式会社	933	3.73
蒲生徳子	718	2.87
株式会社京都銀行	699	2.80
株式会社エヌレガロ	600	2.40
坂東幸子	510	2.04
JP MORGAN CHASE BANK 385151	397	1.59

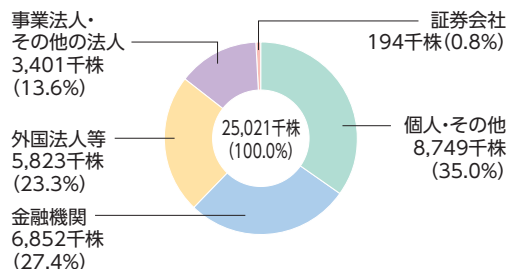
(注1) 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社、日本マスタートラスト信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社の所有株式数は信託業務に係るものです。

(注2) 持株比率は、自己株式(12,560株)を控除して計算しております。

所有者別株主数分布



所有者別株式数分布



TOWAグループ (2019年9月30日現在)

国内

TOWA株式会社
 本社・工場 京都東事業所
 坂東記念研究所 九州事業所
 東京営業所

株式会社バンディック
 TOWATEC株式会社
 TOWAレーザーフロント株式会社

海外

TOWA Asia - Pacific Pte. Ltd. (シンガポール)
 TOWAM Sdn. Bhd. (マレーシア)
 TOWA Semiconductor Equipment
 Philippines Corp. (フィリピン)
 TOWA THAI COMPANY LIMITED (タイ)
 TOWA USA Corporation (米国)
 TOWA Europe B.V. (オランダ)
 TOWA Europe GmbH (ドイツ)

TOWA半導体設備(蘇州)有限公司 (中国)
 東和半導体設備(上海)有限公司 (中国)
 東和半導体設備(南通)有限公司 (中国)
 上海沙迪克軟件有限公司 (中国)
 蘇州STK鑄造有限公司 (中国)
 台湾東和半導体設備股份有限公司 (台湾)
 TOWA韓国株式会社 (韓国)

株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年

定時株主総会 毎年6月

基準日 株主総会権利行使および期末配当 3月31日
 中間配当 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

郵便物の郵送先及び
 電話お問合せ先 〒168-8507東京都杉並区泉東二丁目8番4号
 みずほ信託銀行株式会社証券代行部
 ☎0120-288-324 (フリーダイヤル)

未払配当金のお支払 みずほ信託銀行本店および全国各支店
 みずほ銀行本店および全国各支店
 (みずほ証券では取次のみとなります。)

公告方法 電子公告の方法により行います。但し、やむをえない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。公告掲載URL <http://www.towajapan.co.jp>